

コンバーティングテクノロジー総合展2020

機能性マテリアル
機能性フィルム

多品種小ロット生産
加工機械・成型装置

モノづくりは、価値づくり。

加飾技術
プロダクトデザイン

Flexible Hybrid Electronics
ウェアラブル・次世代IoTデバイス

新機能性材料展2020

機械・機器ゾーン

マテリアルゾーン

新機能ペーパー・繊維ゾーン

複合材料ゾーン

材料設計ソリューションゾーン

試作・受託ゾーン

JFlex2020

3次元表面加飾技術展2020

出展のご案内

2020年1月29日(水)~31日(金)

東京ビッグサイト

主催：株式会社 加工技術研究会

共催：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

Converttech

検索

出展対象

機械・機器ゾーン：コーター／真空成膜装置／ラミネーター・貼合装置／印刷機械／スリッター／巻取機／フィルム製膜装置・関連装置・機器／検査装置／各種制御装置・機器／各種ローラー／ウェブハンドリング関連装置・機器／除塵・静電気除去装置／刃物／試験・計測・分析機器／造粒・粉碎・混合機器／その他周辺機器

マテリアルゾーン：機能性マテリアル／機能性樹脂・機能性添加剤／機能性インキ／機能性コーティング剤／機能性接着剤／高性能フィルム 他

新機能ペーパー・繊維ゾーン：機能紙／紙・特殊紙／パルプ・原料繊維・製紙原料／木質系材料（セルロース・CNF・バイオマスプラスチック）／製紙用薬品／不織布／機能性繊維・繊維シート・複合材料／フィルター 他

複合材料ゾーン：軽量化樹脂素材（熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂・CFRP・GFRP・複合材料）／コンポジット材料（CNT・CNF・ガラス繊維・その他ファイラー）／複合化技術・装置 他

材料設計ソリューションゾーン：材料シミュレーション（ミクロ構造・分子シミュレーション・MI）／モデリング（物性・構造予測など）／材料プロセスシミュレーション／解析ツール（ビッグデータ解析・統計解析など）／その他シミュレーションソフト／コンサルティング

試作・受託ゾーン：受託加工ビジネス／試作請負／その他サービス

新機能性材料展

フレキシブルセンサ：圧力検出／温度検出／ひずみ分布計測／タッチセンサ 他

フレキシブルデバイス・ソリューション：有機 TFT／有機 EL／電子ペーパー／太陽電池、フレキシブル電池／RFID／測定・評価・分析装置・顕微鏡 他

マテリアル：フレキシブル基板（フィルム・繊維・紙・金属箔・ガラス等）／導電性材料（e- テキスタイル、帯電防止剤、導電性高分子、金属インク・ナノインク・ペースト）／絶縁材料／ナノ材料／コーティング剤／その他各種材料

プロセス技術・装置：印刷技術・装置（グラビア、スクリーン、フレキソ、インクジェット、転写印刷、フォトリソグラフィ、その他）／FHE 技術／インプリント／スパッタリング／微細パターン露光装置 他



3次元表面加飾技術展

加飾フィルム・転写箔／加飾・転写装置／各種加飾技術、各種加飾技術、シボ加工／加飾メッキ技術／光沢加工技術 他

出展募集要項

●申込方法

「出展申込書」に必要事項をご記入の上、展示会係宛へFAXにてお申込みください。

1. 仮申込有効期限：2019年6月28日(金)

申込締切日：2019年9月30日(月)

※仮申込の有効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場合、もしくは書面に本申込への切替への連絡がなかった場合、主催者は仮申込を破棄する権利を有します。

※締切前でも予定小間数になり次第締切しますので、お早めにお申込みください。

2. 入金期日：2019年10月31日(木)

※請求書記載の日時が上記と異なる場合、請求書記載の日時までにご出展料を指定口座へお振込みください。

3. 出展申込の取消：出展申込書提出後の取消は原則として出来ません。

※但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、右記の基準で解約料をお支払いいただきます。

※但し、仮予約期限は除く。詳細は出展申込書「裏面 規約1.」をご確認ください。

書面による解約通知を受領した日を基準とする	解約料率
2019年9月30日(月)まで	ご請求額の50%
2019年10月1日(火)以降	ご請求額の100%

●申込小間数および出展料金

(1小間：3m×3m=9m²)

企業	1小間 ¥320,000 (税別)
独法・公的機関・海外パビリオン・学校各研究室	1小間 ¥160,000 (税別)
出展者プレゼンテーション(30分)	1枠 ¥100,000 (税別)

※材料設計ソリューションゾーンのみ、プレゼンテーション15分×2回のセットを¥80,000(税別)でご用意しています。詳細は事務局までお問合せください。

※適用税率に関して：2019年3月31日までに本申込の場合、消費税率8%を適用。2019年4月1日以降の本申込の場合、新税率を適用いたします。

※小間位置は、出展内容、小間数を勘案したうえでお申込順にてご案内します。

●パッケージブースプランのご案内

1小間ブースプラン

※2小間・3小間プランもごさいます。

参考 価格：¥120,000 (消費税別/※予定)

素材：システムパネル

※パッケージブースの料金は参考価格です。

※図はイメージです。



【出展に関するお問合せ先】

株式会社 加工技術研究会

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-6 VORT 岩本町I

TEL: 03-3861-3858 FAX: 03-3861-3894

E-mail: ●新機能性材料展 kinousei@ctiweb.co.jp

●JFlex jflex@ctiweb.co.jp

●3次元表面加飾技術展 con@ctiweb.co.jp

【展示会事務局】

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1

セレスティン芝三井ビルディング12・13階

TEL: 03-5657-0761 FAX: 03-5657-0645

E-mail: ●新機能性材料展 kinousei@jtbcom.co.jp

●JFlex jflex@jtbcom.co.jp

●3次元表面加飾技術展 converttech@jtbcom.co.jp